

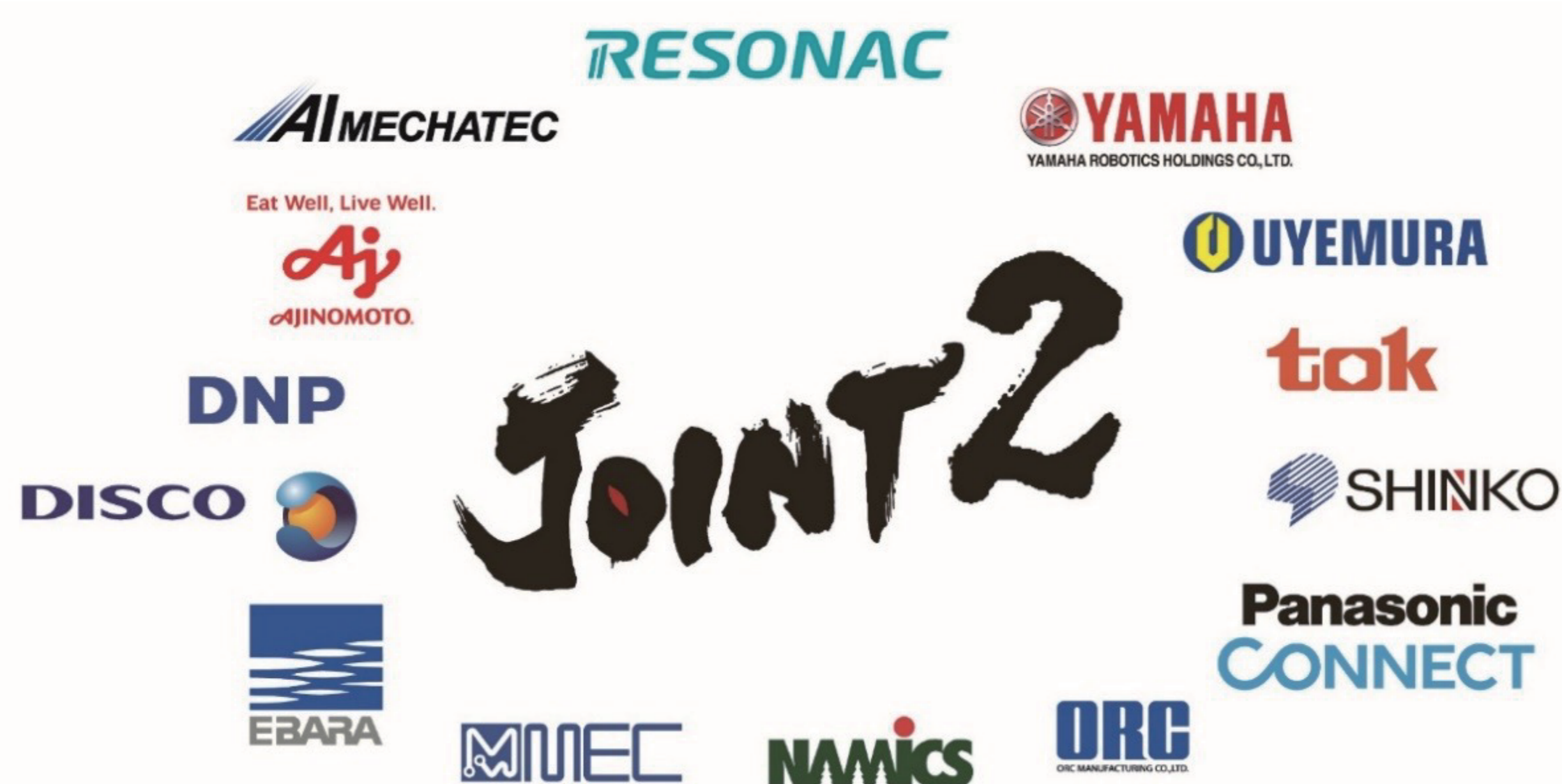
先端半導体パッケージ評価プラットフォーム “JOINT2”

(株)レゾナック ほか

プロジェクト概要

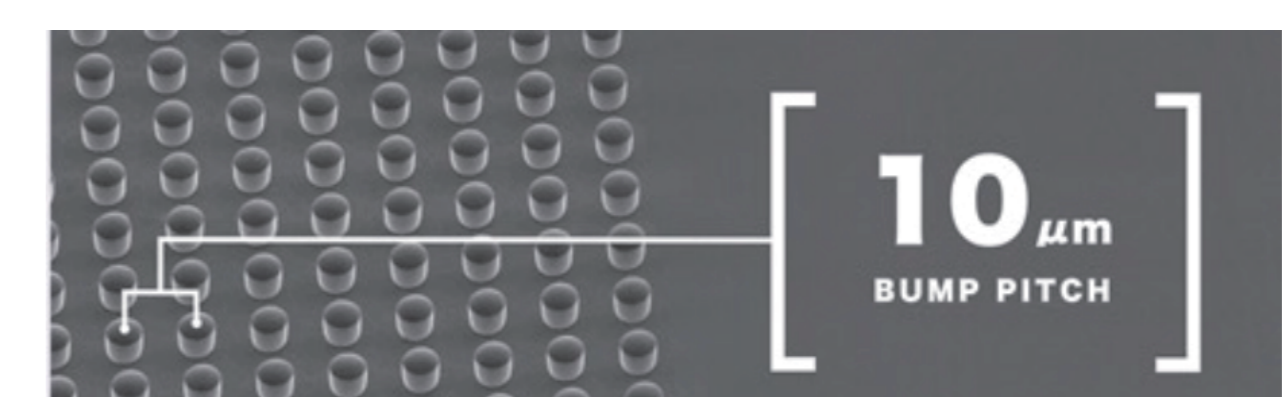
半導体回路の微細化が限界に近づくに伴い、歩留低下・コスト増大が顕在化しています。半導体パッケージのさらなる高機能化や低コスト化のためには、チップレット技術（異種チップ同士を組み合わせワンパッケージにする）を用いたチップ・部材の高密度接続や、それらを搭載する基板の高信頼性・大型化が求められます。JOINT2は上記開発のためのコア技術を保有する基板・装置・材料メーカーで構成されたコンソーシアムであり、3つの事業項目を設けて目標達成に向け開発を行っております。日本の材料・装置・基板技術を結集して、先端半導体パッケージの開発を加速します。

パートナーシップロゴ

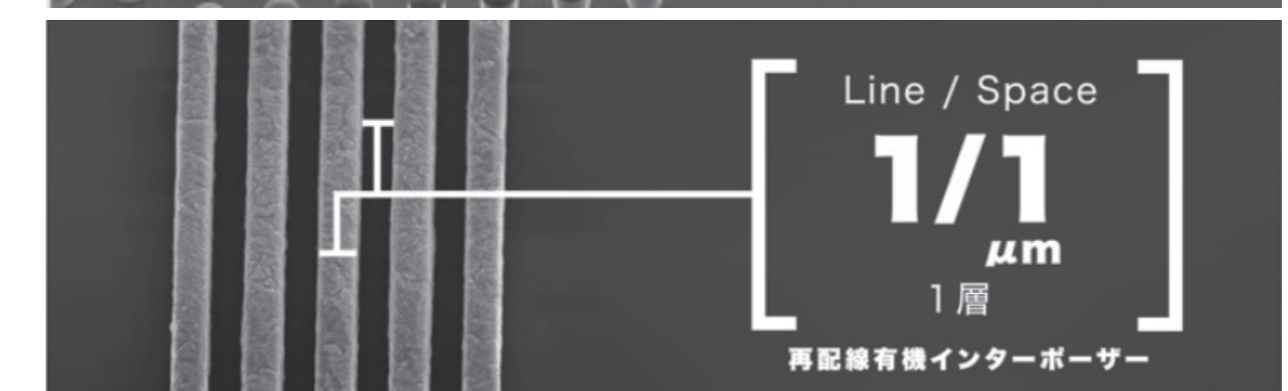


事業項目と最終目標

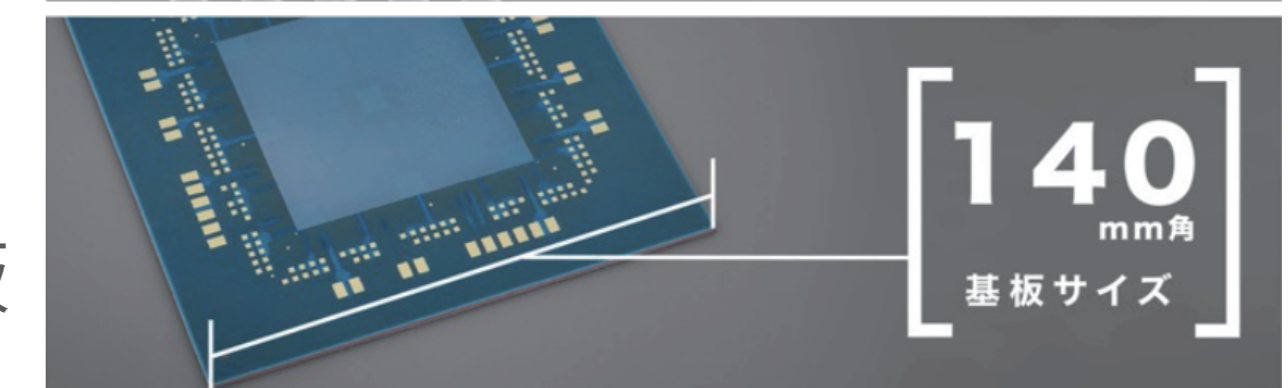
事業項目1：
微細バンプ接合



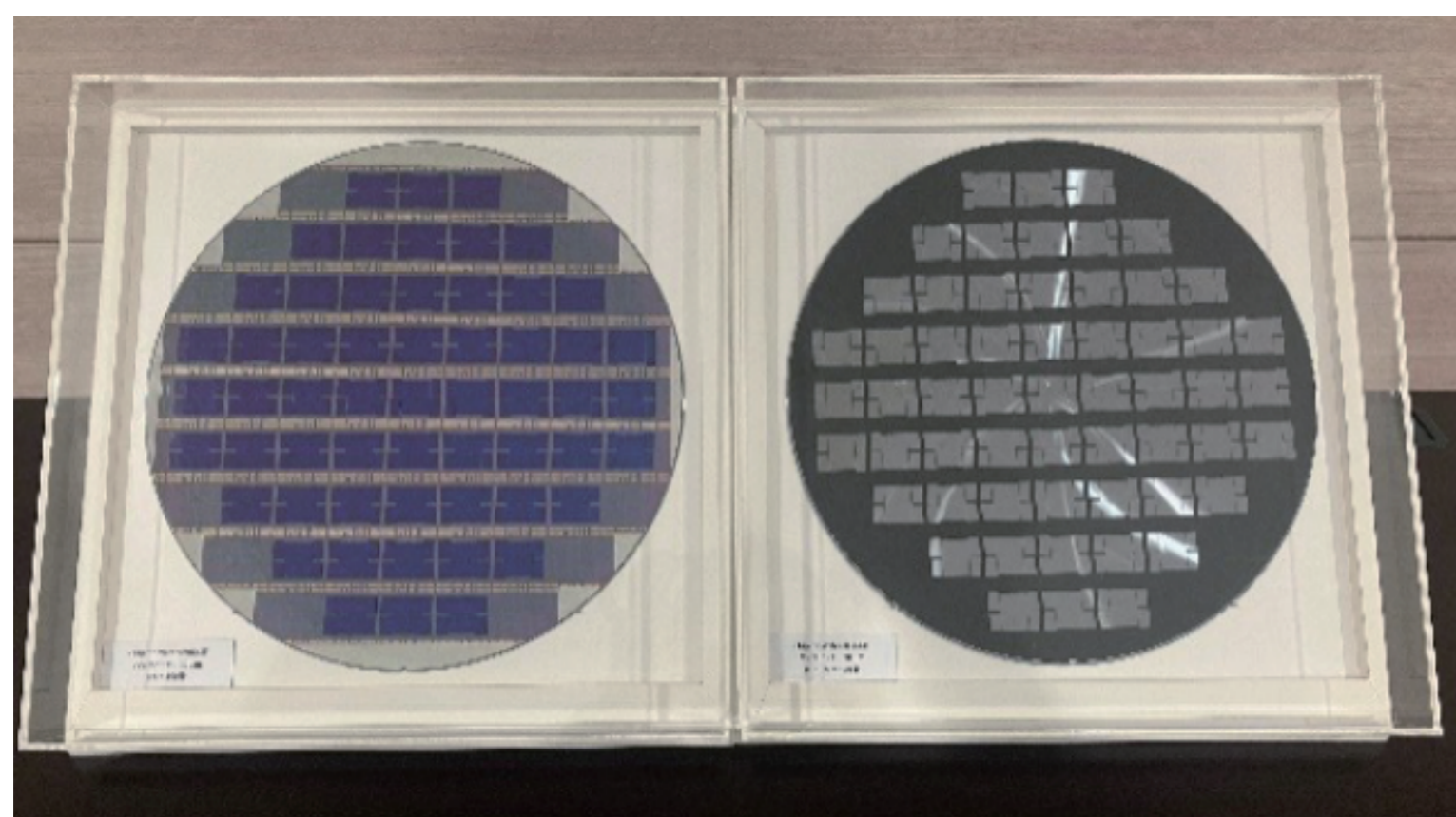
事業項目2：
微細配線形成



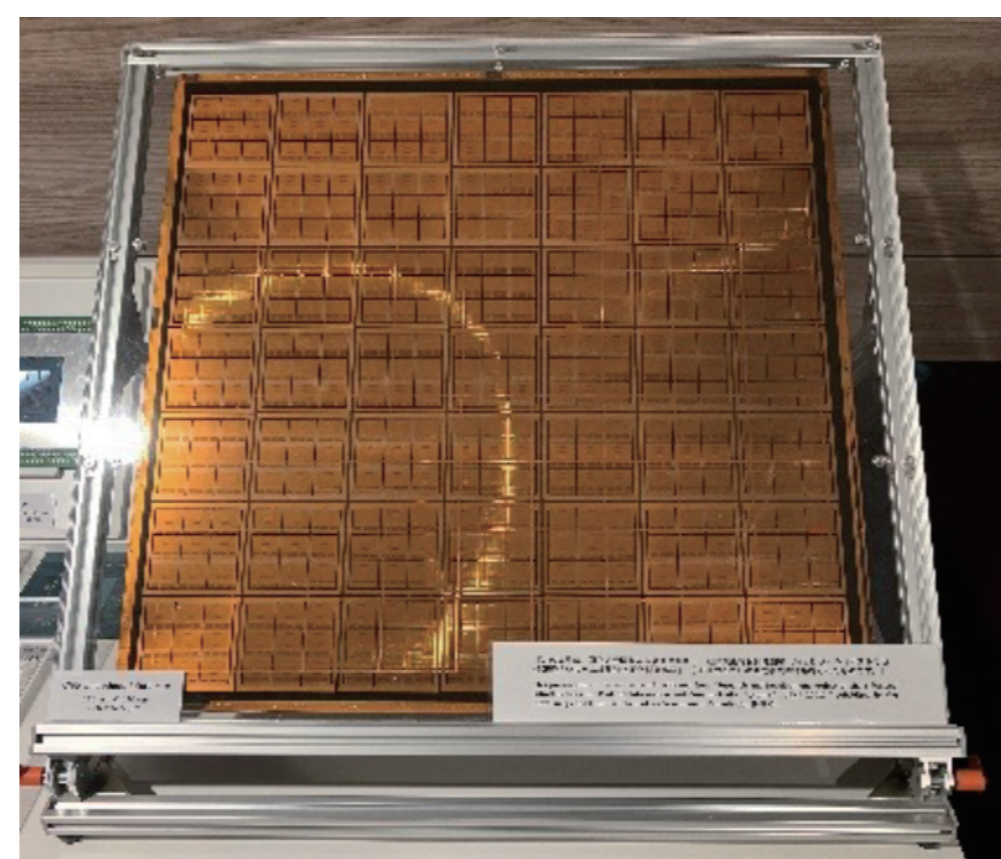
事業項目3：
高信頼性大型基板



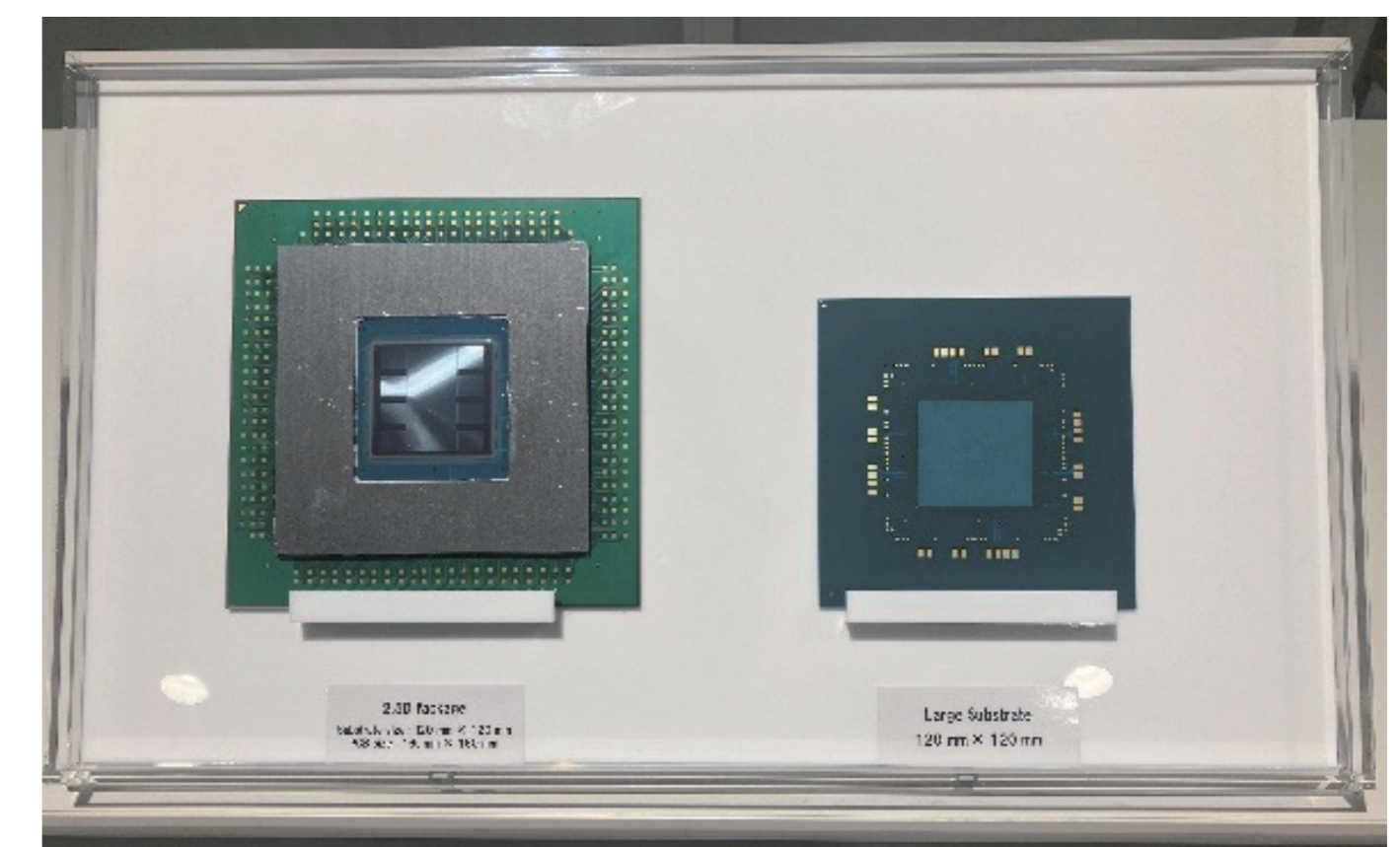
展示物紹介



チップオンウェハ サンプル
(チップ実装後、封止〜グラインド後)

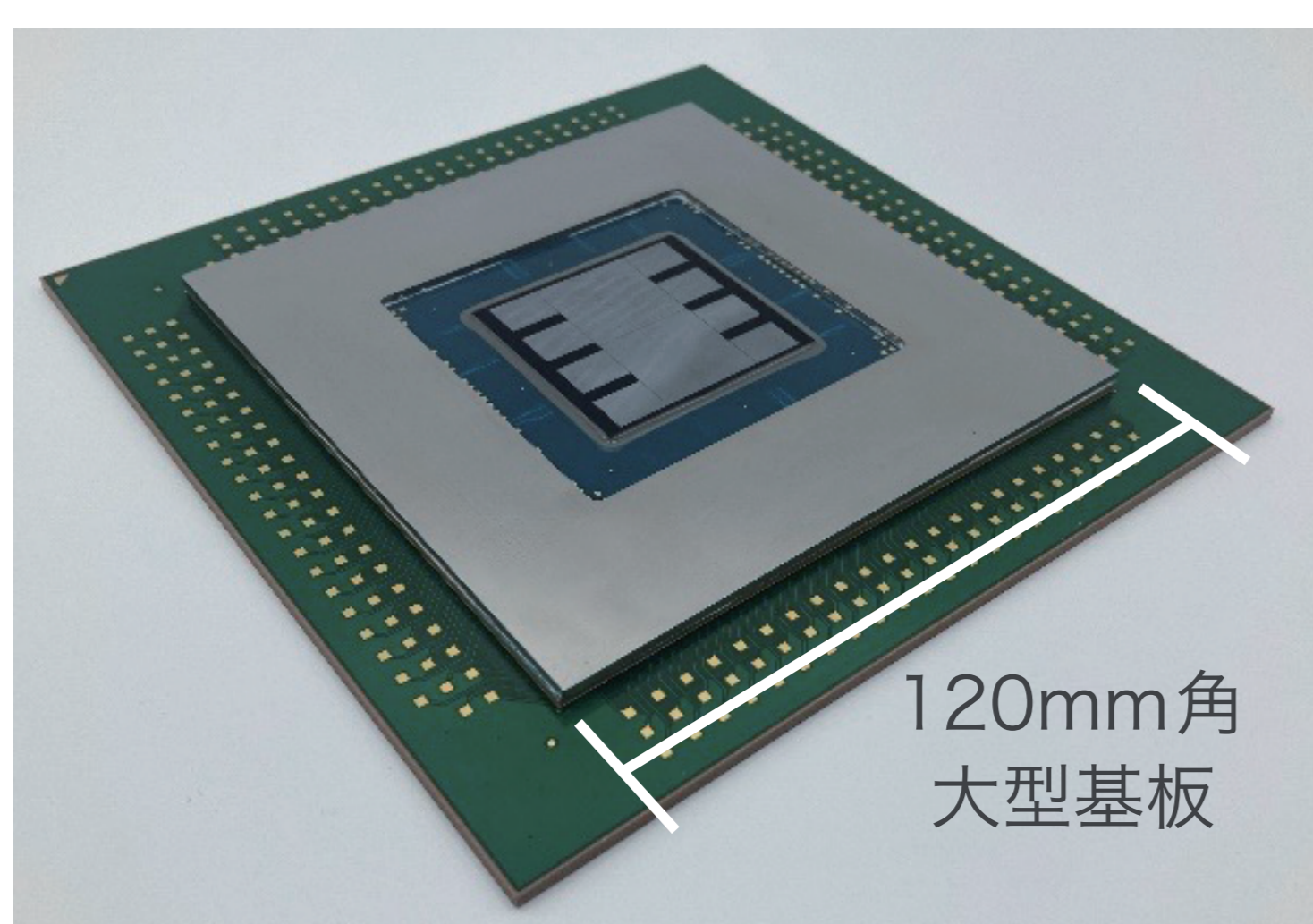


チップ埋込インターポージャー
(パネルサイズ:510×515mm)

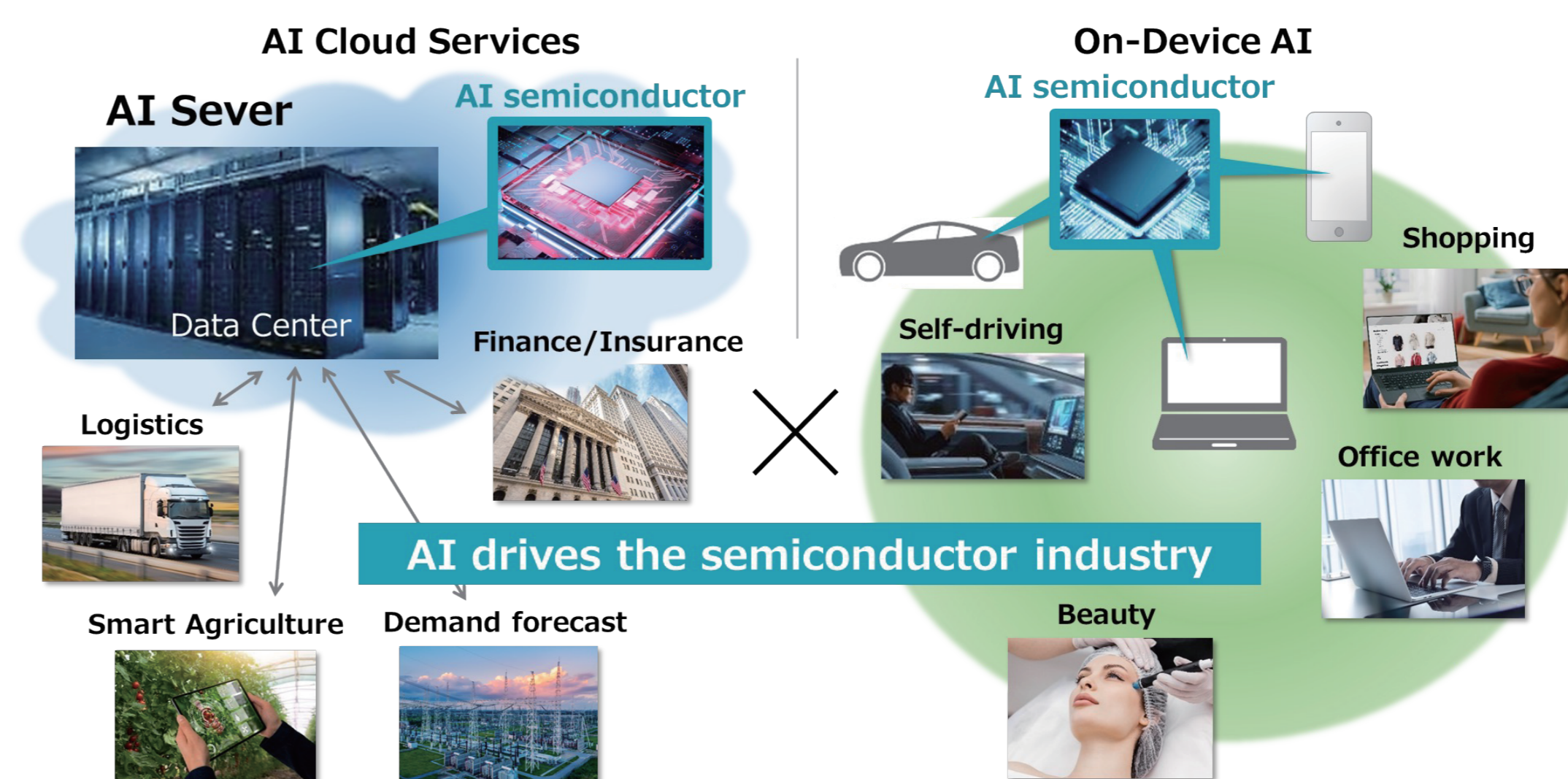


超大型2.5Dパッケージ
(基板サイズ:120mm角)

社会実装イメージ



パッケージのさらなる大型化・高機能化トレンドに
材料・装置・プロセス技術で貢献します



半導体パッケージの進化を通じて
社会と生活をもっと豊かで便利にします

プロジェクト実施期間	2021年8月～2026年7月
NEDOプロジェクト名	ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発／最先端パッケージ評価プラットフォーム創成
お問い合わせ先	株式会社レゾナック https://www.resonac.com/jp/inquiry (お問合せ専用フォーム)